

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成邀請或遊說購入、購買或認購證券之要約，或邀請訂立協議進行上述任何事宜，亦無意招攬任何要約以購入、購買或認購任何證券。本公告並非在中國、香港及美國或其他地方銷售證券之要約。該等債券不可於香港或其他地方進行一般認購。

本公告並不構成或成為於美國購買或認購證券的要約或遊說。本公告所述該等債券並未亦不會根據證券法登記，且除非已根據證券法的登記規定登記或獲豁免登記，否則將不得於美國提呈發售或出售。該等債券不會於美國公開發售。



Semiconductor Manufacturing International Corporation

中芯國際集成電路製造有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：981)

完成發行本金額600,000,000美元二零二五年到期2.693%債券

聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人兼聯席賬簿管理人

J.P.Morgan

ICBC 工銀國際

BARCLAYS

UBS

聯席牽頭經辦人兼聯席賬簿管理人

浦銀國際
SPDB INTERNATIONAL

ICBC 工銀澳門

絲路國際
SILK ROAD INTERNATIONAL

BNP PARIBAS
法國巴黎銀行

本公司欣然宣佈，於二零二零年二月二十七日完成發行本金額600,000,000美元的債券。

茲提述本公司日期為二零二零年二月十九日及二零二零年二月二十日的公告，內容包括建議發行債券（「該等公告」）。除文義另有指明者外，本公告所用詞彙具該等公告所界定的相同涵義。

本公司欣然宣佈，於二零二零年二月二十七日完成發行本金額600,000,000美元的債券。本公司已就債券上市及報價原則上獲得新加坡證券交易所批准。債券於二零二零年二月二十八日在新加坡證券交易所上市。債券原則上獲准上市及報價對本公司或其任何其他附屬公司或聯營公司或債券的優點概無指示性。發行債券所得款項淨額（扣除費用、佣金及開支後）估計將約為596.4百萬美元。

承董事會命
中芯國際集成電路製造有限公司
執行董事、首席財務官兼聯席公司秘書
高永崗

中國上海
二零二零年二月二十八日

於本公告日期，本公司董事分別為：

執行董事

周子學 (董事長)

趙海軍 (聯合首席執行官)

梁孟松 (聯合首席執行官)

高永崗 (首席財務官兼聯席公司秘書)

非執行董事

陳山枝

周杰

任凱

路軍

童國華

獨立非執行董事

William Tudor BROWN

叢京生

劉遵義

范仁達

楊光磊

* 僅供識別